

中信建投证券股份有限公司
关于北京燕东微电子股份有限公司
2025 年半年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	上市公司名称：北京燕东微电子股份有限公司
保荐代表人姓名：张林	联系方式：010-56051430 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦中信建投 11 层
保荐代表人姓名：侯顺	联系方式：010-65608236 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦中信建投 11 层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕2575 号文”批准，北京燕东微电子股份有限公司（简称“公司”或“燕东微”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,986.56 万股，每股面值 1 元。本次公司发行新股的发行价为 21.98 元/股，募集资金总额为 395,344.63 万元，扣除发行费用 19,693.29 万元后，实际募集资金净额为 375,651.34 万元。本次公开发行股票于 2022 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作，出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构与燕东微签订持续督导相关协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解燕东微经营情况，对燕东微开展

	工作内容	持续督导情况
		持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2025 年上半年燕东微在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。	2025 年上半年燕东微在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	在持续督导期间，保荐机构督导燕东微及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促燕东微依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对燕东微内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，燕东微的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促燕东微严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后	保荐机构对燕东微的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况

	工作内容	持续督导情况
	五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2025 年上半年燕东微及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2025 年上半年燕东微及其控股股东不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2025 年上半年，经保荐机构核查，燕东微不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	2025 年上半年，燕东微未发生相关情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事或者高级管理人员	2025 年上半年，燕东微不存在需要专项现场检查的情形

	工作内容	持续督导情况
	涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形。	
16	持续关注上市公司的承诺履行情况。	2025 年上半年, 燕东微不存在未履行承诺的情况

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现燕东微存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）技术迭代风险

半导体行业技术迭代快且工艺制程向先进方向快速发展，给企业带来诸多风险。行业技术密集，分立器件、模拟集成电路新应用场景不断出现，晶圆制造代工客户需求更新快且产品多样，高稳定集成电路及器件向更高性能等方向发展。企业需持续优化设计、升级制造工艺等以跟进趋势。若未能及时推陈出新，跟不上竞争对手在新技术、新工艺上的持续升级，现有产品可能被替代，进而影响企业持续竞争力。

（二）研发不及预期风险

公司近三年研发投入一直保持在 20%以上以维持竞争力，但研发成果存在不确定性。例如，新工艺试产良率若低于行业 80%的基准线，或核心专利申请因技术同质化被驳回，将导致研发投入回报周期拉长。若出现重点研发项目延期会直接影响市场销售策略，对于年度经营计划带来消极影响。

（三）核心技术人才流失风险

半导体核心技术人才是企业技术突破的核心动力，当前，国内半导体产业蓬勃发展，各地积极布局半导体项目，对核心技术人才需求持续增长。人才短缺与流失风险显著。公司若未能完善股权激励计划，核心技术人才或将流失，削弱企业技术攻坚与产品迭代能力。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，燕东微不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年上半年，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	658,941,289.28	616,709,361.77	6.85
归属于上市公司股东的净利润	127,605,338.40	-15,133,992.94	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-389,844,713.50	-73,542,986.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	221,152,782.81	204,997,352.66	7.88
主要会计数据	2025 年 6 月末	2024 年末	本期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	14,769,174,056.01	14,677,831,705.75	0.62
总资产	24,864,047,146.94	24,060,196,692.14	3.34

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.01	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.01	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.32	-0.06	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.86	-0.10	增加 0.96 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.64	-0.50	-2.14
研发投入占营业收入的比例（%）	55.24	18.38	36.86

2025 年上半年，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

（一）归属于上市公司股东的净利润同比上升，主要系公司处置股权，增加净利润所致；

（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，主要系

公司研发投入增长及股权激励摊销费用增加所致；

（三）基本每股收益以及稀释每股收益较上年同期上升，主要系公司处置股权，归属于上市公司股东的净利润同比上升所致；

（四）扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）打造设计、制造、封测一体化产业格局

公司以“全球领先的半导体产业中坚”为愿景，已完成“6+8+12”英寸产线布局。全力打造设计、制造、封测一体化产业格局：

在设计环节，公司有一支兼具丰富 IC 产业经验与专业基础的技术团队，针对分立器件及模拟集成电路、高稳定集成电路及器件开展深入研发，布局多个细分领域。

在制造环节，6 英寸生产线持续开展质量改善活动，产品产出率及良率稳定在业界优秀水平；8 英寸生产线大幅提升运营效率，产出速度、产品良率和产线良率均达到业界标准；65nm 工艺的 12 英寸生产线按照项目建设目标加速推进；28nm 工艺的 12 英寸生产线项目工程建设按计划封顶，相关研发工作同步开展；封测资源进一步丰富，保障产品的良品率和可靠性。

公司一体化产业格局稳固成本优势，为后续规模扩张筑牢根基。

（二）布局全产线工艺平台，硅光实现新突破

公司以突破技术瓶颈、掌握核心技术，形成差异化竞争，抢占市场高地为目标注重研发投入以及全产线工艺平台布局。2025 年上半年研发费用达 3.64 亿元，同比增长 221.21%。公司已建设完成 6 英寸、8 英寸、12 英寸生产线，工艺平台更加完善。6 英寸 Si/SiC 基生产线工艺平台涵盖 TVS、Planar MOS、IGBT、FRD、MEMS、VDMOS、SiC 等；8 英寸 Si 基生产线工艺平台涵盖 Planar MOS、Trench MOS、FRD、BCD、CMOS、SiN 硅光等；12 英寸 Si 基生产线工艺平台涵盖 TMBS、Trench MOS、CMOS、LCD driver、硅光等。截止 2025 年 6 月，硅光领域实现

里程碑式突破，自主研发的 SiN 硅光工艺平台在量产交付、产能提升、客户拓展等领域均获得市场认可，为后续长期发展奠定了良好基础。

（三）高稳定集成电路及器件产品客户深度绑定，市场空间广阔

公司拥有数十年的技术沉淀，具备极为完善的设计制造、封装测试、可靠性试验、失效分析和质量评价基础能力。产品系列丰富，涵盖光电、数字、模拟及混合集成电路等，可满足诸多应用场景。凭借产品高可靠性以及良好的市场认可度，与高稳定领域客户建立了长期稳固合作关系。未来随着行业的持续发展以及自身的不断进取，其发展空间更为广阔。

（四）人才矩阵不断丰富，保障公司持续健康发展

公司注重人才矩阵建设，锚定“强基本、扩增量、调结构、激活力”总体思路，构建符合战略需求、符合行业规律的人才管理体系，保障公司持续健康发展。

依托“燕东微芯产业工程师培养联合体”，聚焦产、学、研、用方向，打造人才生态闭环，强化现有人才队伍能力提升。围绕未来产业发展，公司储备不同领域的高层次人才，以保障持续发展为导向，调整组织架构，人才队伍矩阵不断丰富，制定更加科学合理的激励制度，进一步激发企业活力。截至 2025 年 6 月，公司现有研发人员 450 人，占员工总数 14.75%。

七、研发支出变化及研发进展

（一）报告期内获得的研发成果

1、基于成套国产装备的 65nm12 英寸生产线，依托核心技术突破与工艺平台搭建，推动产能加速释放，实现技术与产业协同进阶，其中：

（1）高密度功率器件工艺平台：突破多项关键技术，完成低压 SGT、Trench NMOS（0.7um pitch）、650V IGBT 等多个工艺平台搭建，导入上百款芯片，数十款产品交付客户验证；

（2）硅光工艺平台：通过工艺优化、器件结构调整，破解波导插损等难题，核心器件研发获实质进展。

2、基于成套国产装备的 8 英寸生产线，持续丰富工艺平台，加速产品结构

调整，促进业务版图拓展，实现产能与效益提升，其中：

（1）SiN 硅光工艺平台：持续推进平台建设与业务拓展，实现产能释放；

（2）超高压 BCD 工艺平台：600V BCD 工艺平台发布 PDK 0.5；700V BCD 工艺平台通过“压缩划片道”，芯片出芯率提升 5%；

（3）HV CMOS 工艺平台：LED 点阵屏驱动 IC WAT 电参数符合出货要求，提交客户进行产品验证；

（4）IGBT 工艺平台：完成全流程开发和工艺固化，典型产品通过 1000h 可靠性评测；

（5）RF-LDMOS 工艺平台：实现全流程贯通，2.45G 产品工程批产出，通过客户验证；

（6）TVS 工艺平台：完成 Trench TVS 工艺平台搭建，典型产品完成流片，启动封装验证；

3、基于 6 英寸 SiC 生产线，持续提升工艺技术能力，小 pitch MOSFET 技术验证版完成首轮产品流片，确认工艺基限。

4、基于自有设计以及封测资源，通过强化产业协同效能，提升产品迭代速度与市场响应能力，其中：

（1）高压射频 VDMOS 芯片：面向半导体设备高端射频电源应用领域，完成 6 款芯片研制；

（2）射频功率模块封装：完成 DS100UM45 模块研制和电性能测试，启动客户端应用评估。

（二）报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	17	8	192	101
实用新型专利	20	9	360	325
外观设计专利	0	0	0	5

软件著作权	0	0	46	49
其他	18	0	58	29
合计	55	17	656	509

(三) 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	364,013,289.44	113,326,255.02	221.21
资本化研发投入	/	/	/
研发投入合计	364,013,289.44	113,326,255.02	221.21
研发投入总额占营业收入比例（%）	55.24	18.38	36.86
研发投入资本化的比重（%）	/	/	/

研发费用同比上升 221.21%，主要系 12 英寸项目加大研发投入。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	3,756,513,376.97
累计投入募集资金总额	3,774,054,827.45
(1) 募集资金投资项目投入	1,349,705,105.18
其中：本年度募集资金投资项目投入	0.00
(2) 募集资金投资项目先期投入及置换	1,653,955,722.27
(3) 补充流动资金	770,394,000.00
其中：本年度补充流动资金	71,600,000.00
加：累计利息收入（减手续费）	58,227,981.55
其中：本年度利息收入（减手续费）	288,660.81
2025 年 6 月 30 日募集资金余额	40,686,531.07
(1) 募集资金专项账户期末余额	35,686,531.07
(2) 用于现金管理尚未到期金额	5,000,000.00

公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务

管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



张 林



侯 顺

